

AMD stellt zwei neue umfassende Plattformen für Embedded Systeme vor

Die neuen Low-Power Hochleistungs-CPU's, Chipsätze und Grafik bieten zahlreiche neue technische Möglichkeiten, die Vorteile der x86-Technologie sowie Single-Source Komfort



SAN JOSE, Kalifornien, 5. Mai 2010 - Auf der Embedded Systems Conference stellte AMD (NYSE: AMD) heute zwei neue umfassende Plattformen für den Embedded-Markt vor: die kompakte [ASB2 Plattform](#) (BGA) und die High-Performance [AM3 Plattform](#). Sie ermöglichen unzähligen Leistungs- und Performance-Kombinationen mit im Vergleich zu früheren Generationen bis zu 74 Prozent mehr Leistung pro Watt.*

AMD's neue flexible Embedded-Plattformen bestehen aus Chipsatz- und Grafik-Lösungen in Kombination mit Hochleistungs-CPU's, die zur Entwicklung einer idealen Lösung auf Basis der [Applikationsanforderungen](#) einen sehr geringen Energieverbrauch von 8W TDP haben. System-Designer, die im Schwerpunkt Produkte der nächsten Generation entwickeln, sehen den unmittelbaren Nutzen dieser Plattformen gemeinhin in den Vorteilen des Industriestandards x86er Prozessoren inklusive stromlinienförmigem Design und Entwicklung, im großen Software-Ökosystem sowie in schneller Time-to-Market.

"Die umfassende Verbreitung von x86er Technologie wurde für den Markt der Embedded Systeme bislang durch die Kombination aus Leistung, Preis und Silizium-Größe limitiert", sagte Buddy Broeker, Direktor der Embedded Solutions

Division von AMD. "AMDs Embedded-Lösungen haben diese Einstiegsbarriere stets herabgesetzt. Obendrein wurden Enterprise-Class-Performance sowie weitere Funktionen hinzugefügt, die Designern in der Vergangenheit nicht ohne weiteres zur Verfügung standen. Unser Engagement für den Embedded-Markt intensiviert sich, da für den Embedded Markt auch die Einführung der Produkte mit AMD Fusion™ Technologie bevorsteht."

Im Markt werden die Vorteile des AMD Ansatzes für x86er Technologie mit den kompletten Plattform-Lösungen von führenden Unternehmen der Embedded Industrie unterstützt. Lesen Sie, was beispielsweise [iBASE](#) oder [Quixant](#) zu diesen [AMD Embedded Solutions](#) sagen.

Die Features der neuen Plattformen

- Schnellerer Speicher dank der Unterstützung von 2 DDR3 Kanälen
- Mit der HyperTransport™ 3.0 Technologie verbessert sich die I/O Performance für hohen Datendurchsatz und Echtzeit-Anwendungen
- Für hoch zuverlässige Anwendungen wie SMB/SOHO-Storage-Systeme wird ECC unterstützt.
- Die vielfältigen CPU Optionen bieten eine große Auswahl bei Performance und Leistung:
 - Es gibt mit 8, 12, 15, 25, 45 und 65 Watt 6 TDP Varianten
 - in Single-, Dual- und Quad-Core Strukturen
 - bei einer Taktung, die bis hin zu 2,8 GHz reicht.*
- Der AMD 785E-Chipsatz unterstützt PCI Express® 2.0
- Die neue ATI Radeon™ HD 4200 Grafik bietet DirectX® 10.1, volle 1080p-Auflösung und HDMI sowie Power-Spar-Fähigkeit und die Optionen zur mehrere Displays zu unterstützen.
- Der Sockel des AM3 Pakets ist mit dem AM2 Sockel kompatibel, wenn DDR2-Speicher zum Einsatz kommt, was mehr Design-Flexibilität und Skalierbarkeit bietet.

- Das ungesockelte BGA-Paket ist kostengünstig in der Herstellung, hoch zuverlässig und die niedrige Bauhöhe ist ideal für kleine Formfaktoren und lüfterlose Designs.

Die Prozessor-Varianten, die jeweils mit dem AMD785E / SB850M Chipsatz kombiniert werden und die die Direct Connect Architecture unterstützen, mit der das Board Design vereinfacht wird, reichen bei der ASB2 Plattform vom AMD Turion™ II Neo Single Core Prozessor mit 1,0 GHz bis hin zum AMD Turion™ II Neo Dual-Core Prozessor mit 2,2 GHz. Die AM3 Plattform ist vom Athlon II XLT Dual Core Prozessor mit 2,0 GHz bis hin zum AMD Phenom™ II XLT Quad-Core Prozessor (2,2 GHz) skalierbar. In der Summe wurden neben dem AMD785E 9 Performanceklassen gelauncht, wobei alle 64-bit unterstützen:

ASB2 (rugged BGA Plattformen)

- 25W AMD Turion™ II Neo (Dual-Core, 2.2GHz, HT3)
- 15W AMD Turion II Neo (Dual-Core, 1.5 GHz, HT3)
- 12W AMD Athlon II Neo (Dual-Core, 1.3 GHz, HT1)
- 12W AMD Athlon II Neo (Single-Core, 1.7 GHz, HT1)
- 8W AMD Athlon II Neo (Single-Core, 1.0 GHz, HT1)

AM3 (gesockelte Plattformen)

- 65W AMD Phenom™ II XLT (Quad-Core, 2.2GHz, HT3)
- 45W AMD Athlon II XL (Dual-Core, 2.8GHz, HT3)
- 45W AMD Athlon II XLT (Dual-Core, 2.7GHz, HT3)
- 25W AMD Athlon II XLT (Dual-Core, 2.0 GHz, HT3)



Unterstützende Ressourcen

[iBASE Gast-Post im Blog \(englisch\)](#)

[Quixant Gast-Post im Blog \(englisch\)](#)

[AMD @ Work Blog \(englisch\)](#)

[Presse Präsentations-Slides \(englisch\)](#)

[Fotos](#)

* Der AMD-interne Test der aktuellen Generation im Vergleich zu früheren AMD Prozessor basierten Embedded-Systemen vom 1. April 2010 zeigte bis zu 74% mehr Performance-pro-Watt für die heutige Generation. Das gegenwärtige System (AMD Athlon™ II Neo R34L (8W TDP), Bimini-Entwicklungsplattform, AMD 785-Chipsatz, 2 GB RAM, Windows XP SP2) wurde dazu mit der vorherigen Generation verglichen (AMD Sempron™ Prozessor 2010U (15W TDP), MSI 9858 Mainboard, 2 GB RAM, Windows XP SP2). Die Performance-pro-Watt wurde dabei aus dem Mittelwert von drei Benchmarks ermittelt, wobei die Performance durch die Thermal Design Power (TDP) geteilt wurde. Die durchgeführte Benchmarks waren 3DMark® 06, POV-Ray sowie SiSoftware Sandra 2007 (Prozessor Arithmetik, Speicherbandbreite und Performance Index wurden als Subtests durchgeführt).

About AMD

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) is an innovative technology company dedicated to collaborating with customers and technology partners to ignite the next generation of computing and graphics solutions at work, home and play. For more information, visit <http://www.amd.com>.

AMD, the AMD Arrow logo, ATI, the ATI logo, Radeon, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft, Windows, and DirectX are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other jurisdictions. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.



Leserkontakt:

AMD
+49-89-45053145
Embedded.europe@amd.com
www.amd.com/embedded

Bei Veröffentlichung bitten wir um Zusendung je eines Belegexemplars an nachstehende Kontaktpersonen:

Redaktionskontakt:

SAMS Network
Sales And Management Services
Michael Hennen
Zechenstraße 29
52146 Würselen
Germany
Tel. +49 (0)2405-4526720
Fax +49 (0)2405-4526721
[Mailto:Michael.Hennen@sams-network.com](mailto:Michael.Hennen@sams-network.com)

Aurelius Wosylus
Regional Sales Manager Europe
AMD GmbH - Embedded Business Unit
Karl-Hammerschmidt-Str. 34
85609 Dornach b. München
T +49 89 450 53 145
M +49 162 292 63 75
Email aurelius.wosylus@amd.com
Web: www.amd.com/embedded